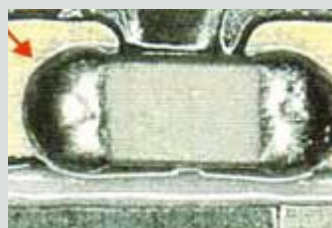


【原因、判断要点、发生工序】焊料の含銅量等太多所引起的（HAL 工序）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】

The defect is caused by an excessive high copper content of solder bath (HAL process)



【コメント】
顕微鏡倍率×

【注釋】
显微镜倍率 ×

【Comments】
Magnification: ×

4-3-1-2 はんだ光沢不良／焊料无光泽 / Poor solder luster

【特徴】はんだコーティング表面の光沢が無く、くすんだ状態の欠陥

【特征】热风整平の表面无光泽，发暗的缺陷。

【Characteristics】The surface of coated solder is lusterless and dull.

【原因・判断ポイント・発生工程】はんだの成分異常（銅含有量過多等）やはんだめっき後に表面が擦れて二次的に出来たものの二通りが存在する（はんだコーティング工程、はんだコーティング後）

【原因、判断要点、发生工序】焊料的成分异常（含銅量太多等），或者热风整平后表面被摩擦所引起的（热风整平工序、热风整平后）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】

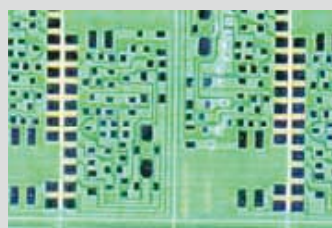
There are two kinds of causes for the defect. One is an anomaly in solder composition (such as too much copper content). The other is by handling after solder coating, such as rubbing on the solder surface. (Solder coating process and after coating)



【コメント】
顕微鏡倍率×

【注釋】
显微镜倍率 ×

【Comments】
Magnification: ×



【コメント】
顕微鏡倍率×

【注釋】
显微镜倍率 ×

【Comments】
Magnification: ×

4-3-1-3 組成異常はんだ濡れ不良／成分异常，润湿性差 / Poor solder wetting by improper solder composition

【特徴】はんだの濡れ性が悪く、はんだが上がり難い状態の欠陥

【特征】润湿性差，爬锡困难的缺陷。

【Characteristics】Solder wettability is poor and good solder fillet is hard to form.

【原因・判断ポイント・発生工程】銅含有量過多などのはんだ組成異常により出来たもの（HAL 工程）



【コメント】
顕微鏡倍率× 25

【注釋】
显微镜倍率 × 25

【Comments】
Magnification: ×25